

檔 號：
保存年限：

台北市電腦商業同業公會 函

地址：105 台北市松山區八德路三段 2
號 3 樓
聯絡人：丁小姐
電話：(02) 2577-4249 分機 976
傳真：(02) 2578-6427

受文者：臺北市立松山高級工農職業學校

發文日期：中華民國112年9月15日
發文字號：電會字第1120005513號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：論壇 EDM (0005513_att24758.pdf)



主旨：2023 台灣創新技術博覽會-未來科技館國際趨勢論壇隆重
登場，惠請貴校鼓勵師生踴躍參與。

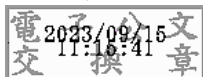
說明：

- 一、由國科會舉辦的未來科技館國際趨勢論壇將針對半導體、太空科技、淨零科技等關鍵議題將於 10 月 12 至 14 日在世貿一館登場！
- 二、12 日半導體趨勢論壇將以半導體的創新應用與關鍵突破為主題、13 日太空科技論壇將關注未來太空破壞性創新技術、14 日淨零科技趨勢論壇將探討討論應對氣候變遷的挑戰與新創機會，論壇邀請全球及國內專業人士現身分享，機會難得歡迎報名<https://reurl.cc/p5gd5Z>
- 三、論壇聯繫窗口：台北市電腦公會丁小姐，電話：(02)2577-4249 分機 976 ；電子郵件：winnie_ting@mail.tca.org.tw。



正本：各大專院校、各高中職

副本：



台北市電腦商業同業公會



裝

訂



線